

安全评价报告信息公开表格（至芯半导体（杭州）有限公司）

被评价单位名称		至芯半导体（杭州）有限公司
评价项目名称/项目编号		深紫外UVC芯片项目（一期）安全验收评价/第2008040号
项目简介（含图片）		<p>本项目租用杭州大江东地产开发有限公司现有厂房，生产深紫外UVC芯片。</p> 
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司
项目组长		张奇峰
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		赵颖斌
评价报告编制人		张奇峰、汪胜红
报告审核人		李春平
参与评价工作	安全评价师	张奇峰、汪胜红
	注册安全工程师	张奇峰、汪胜红
	技术专家	相继园、张永良
现场开展安全评价工作	人员	张奇峰、汪胜红
	时间	2022.10.05-2022.12.20
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2022.12.20